



中華民國專利證書

發明第 I 894751 號

發明名稱：低介電高Tg的樹脂組成物、預浸漬片及金屬積層板

專利權人：南亞塑膠工業股份有限公司

發明人：廖德超、黃威儒、張宏毅、劉家霖、廖仁煜

專利權期間：自 2025 年 8 月 21 日至 2043 年 12 月 26 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長

廖承威

中華民國



114

年

8

月

21

日

